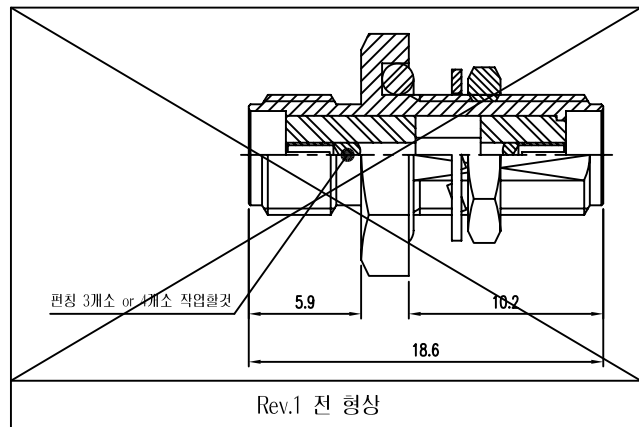
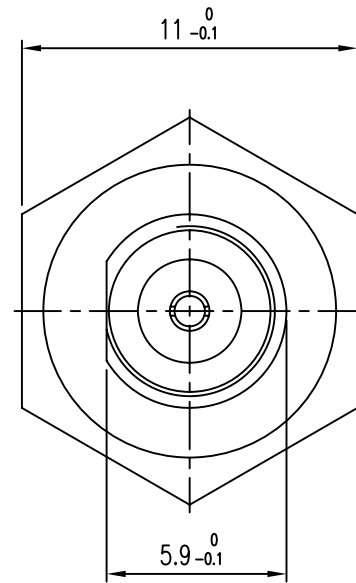
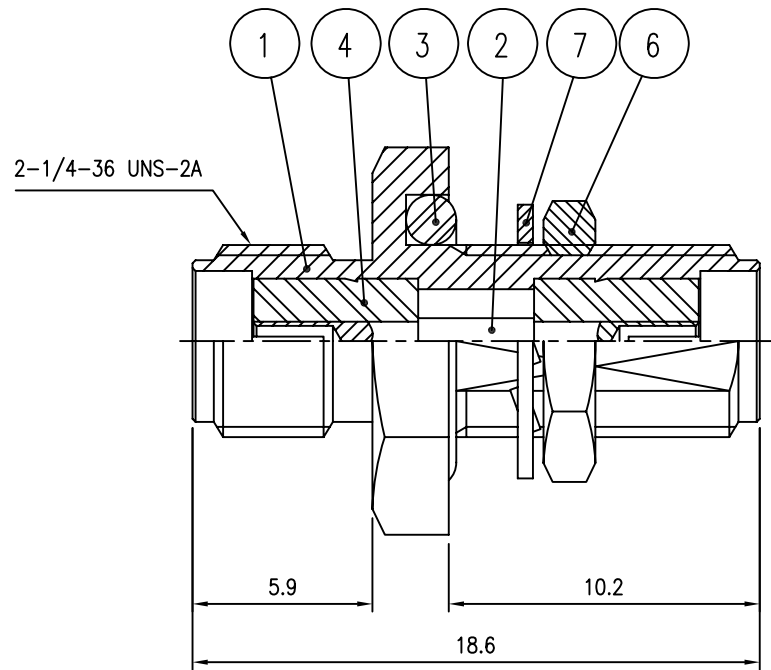


1										수 정 내 용				
가공										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)										1	배타 PUNCH -> HOOK 구조 변경	은선영	김인철	2021. 06. 01.
ST(개선)														



7	WASHER	1	BsS	Gold Plate(유광)	DWA00005-5/1 (Q2008)
6	NUT	1	MBsBD	Gold Plate(유광)	DNT00025-5/1 (N2002)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00216-N/1 (H2261)
4	INSULATOR	2	TEFLON		DIN01973-N/1 DIN00126-N/1 (H2100)
3	GASKET	1	SILICONE	RED BLACK	DGK00023-N/2 DGK00023-N/1
2	CONATCT	1	BeCu	Gold Plate(유광)	DCT00079-5/2 DCT00079-5/1 (E2173)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate(유광)	DBD01704-5/2 DBD01704-5/1 (D2180)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 * ±0.1 ** ±0.05	년월일 2006. 5. 2.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	승인					
	재질	검도	도명 SMA50 (J) SMA50 (J) BH			
열처리	재도					
보호파막처리	작성부서 연 구 소			A4	도번 AD00215-7/1	
	적도 4/1	단위 mm	종량		K314-700-012	